

开发板下载程序使用说明

本文档主要简单介绍开始使用各系列芯片开发板、程序和烧写方面的基本信息，以下介绍的开发板底板适用于各系列芯片，更换各系列芯片上层仿真板即可。下载程序 IDE 各系列芯片开发都适用。

步骤一：打开对应的应用工程 SDK，例如“AC319N_SDK_V003”，如下图 1 和图 2。

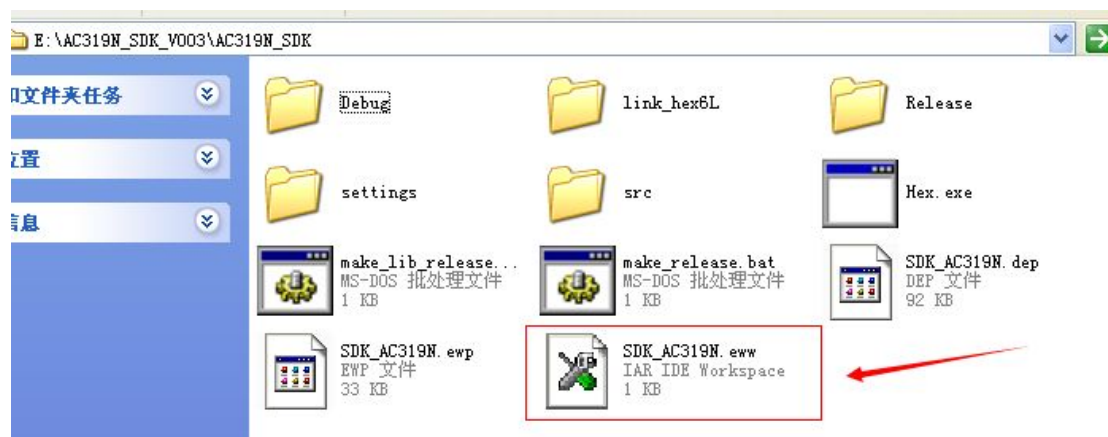


图 1

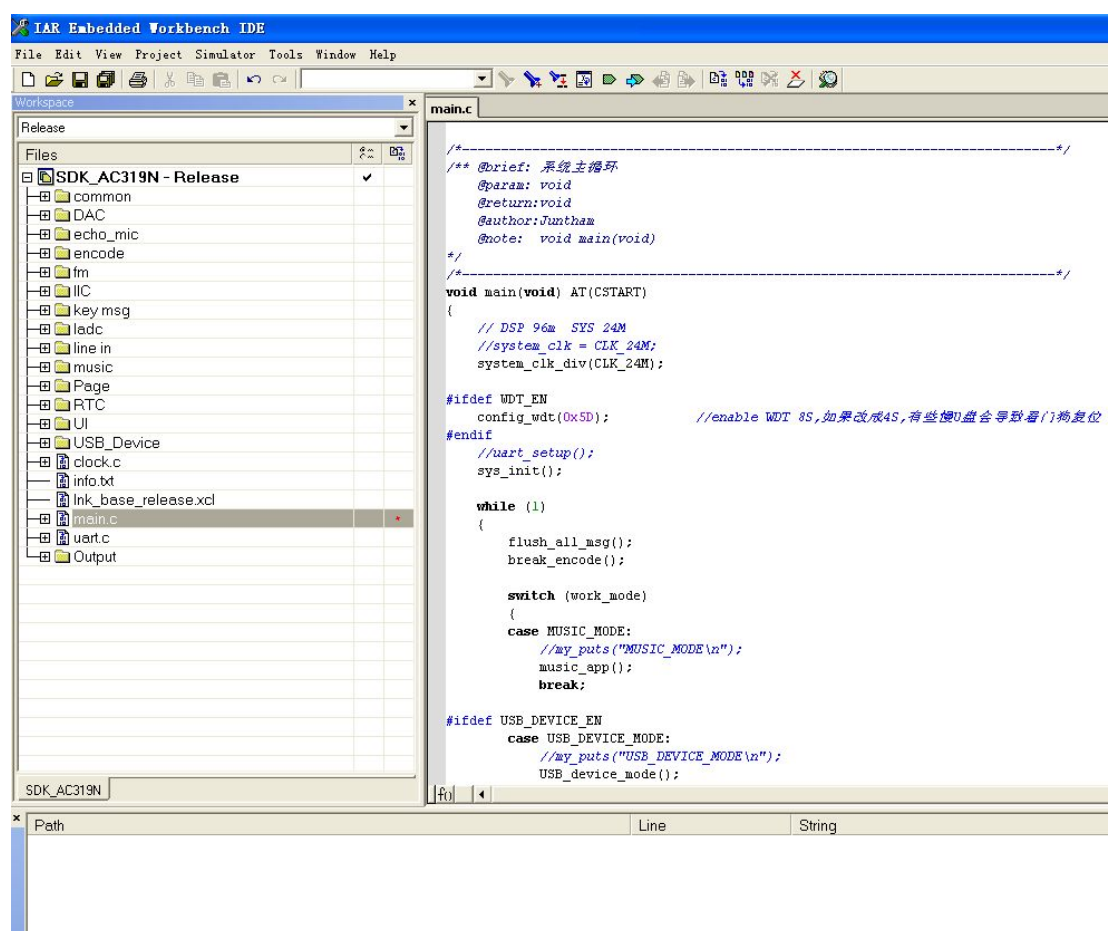


图 2

步骤二：搭载好开发环境，如下图 3 开发板总体硬件开发环境。图 4 是对应下载程序的 IDE，图 5 是开发板的仿正板。

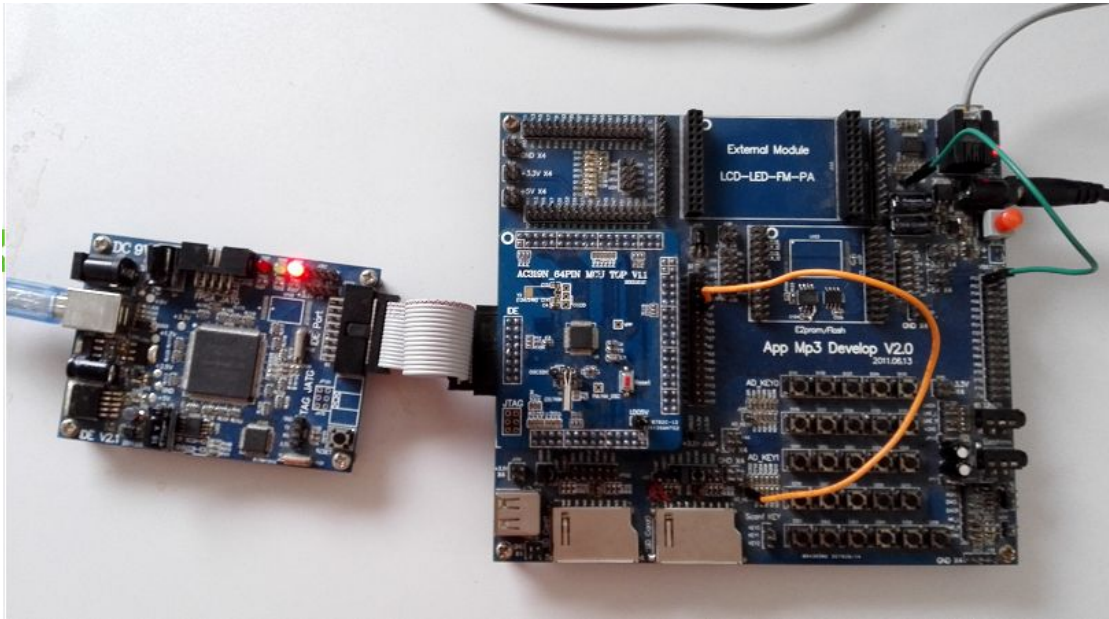


图 3

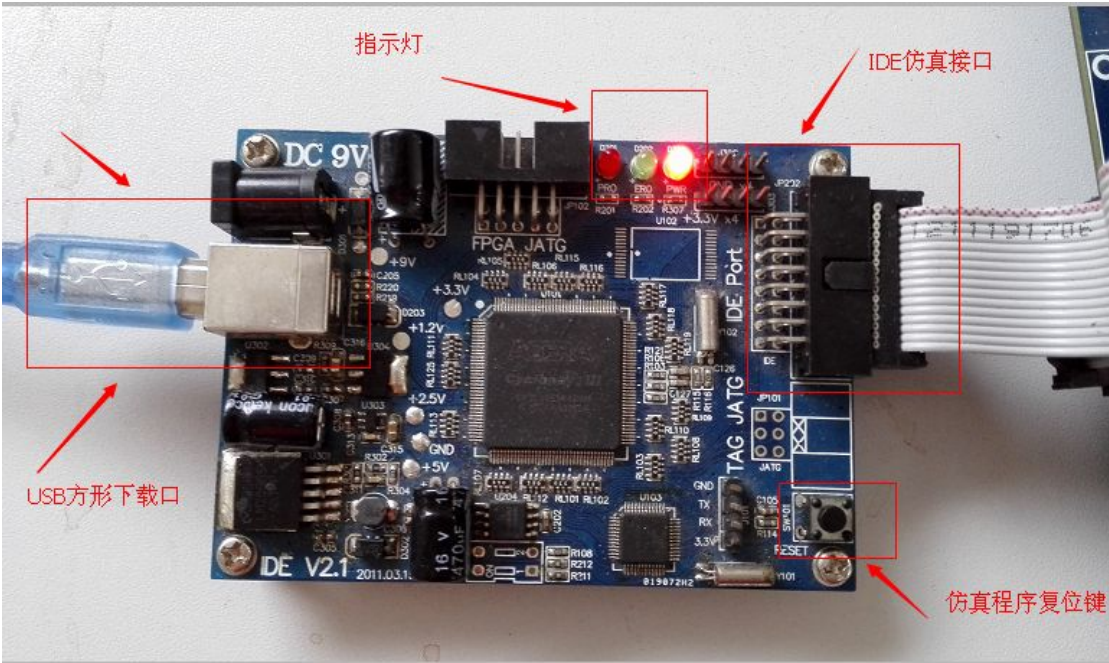


图 4

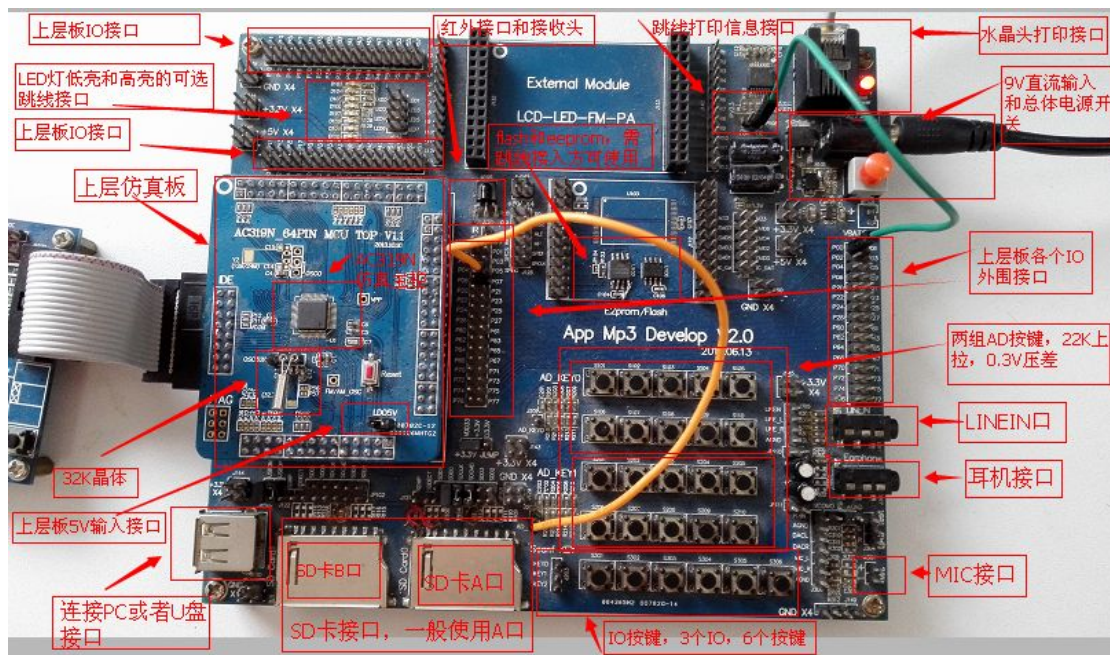


图 5

步骤三：在 config.h 配置好各项宏定义，因为仿真板使用的是 32K 晶体，打开宏定义#define CLK_USE_32K_NO_HTC，注释掉其他定义，如下图 6。

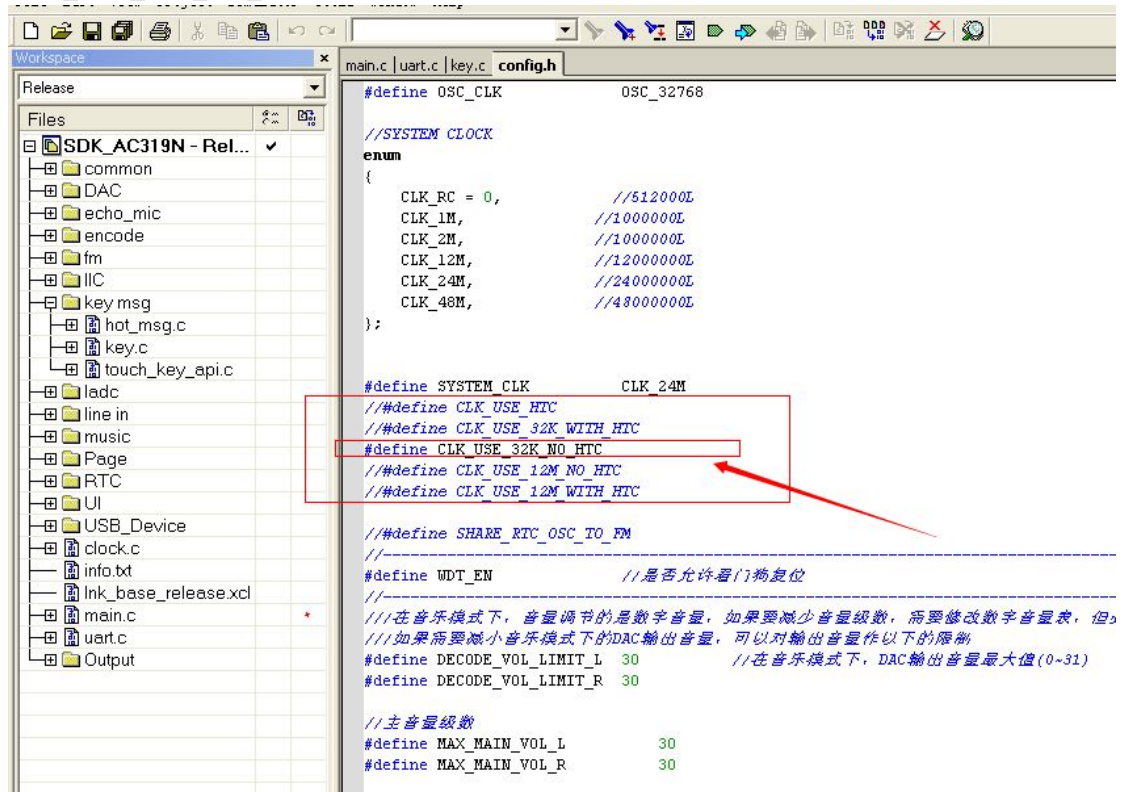


图 6

SDMMC 卡使用的是#define SDMMCA_EN，发出的 SDK 已是此定义。

然后，可空过快捷键 F7 也可以通过编译器的菜单选项“project->make”直接编译下载程序到开发板，看到 IDE 的灯在闪烁，证明程序已下载入开发板，此时插入 U 盘或者 SD 卡，即可从 Earphone 口听到声音。

步骤四：生成的烧写文件放在工程的...\AC319N_SDK\link_hex6L 文件夹内的 myoutotp.bin.fw 文件，后缀为 fw。到时通过烧写器烧写芯片，同样也是通过此 FW 文件下载入烧写器，然后烧写芯片。

步骤五：如下图 7。是烧写各系列主控程序的烧写器。客户可通过把开发好的程序通过 USB 接口下载入烧写器，然后拔掉 USB 口，在上电，当听到烧写器“嘀嘀嘀”三声后，已准备好烧写，即可通过上层烧写座放置对应烧写座封装芯片，进行烧写。

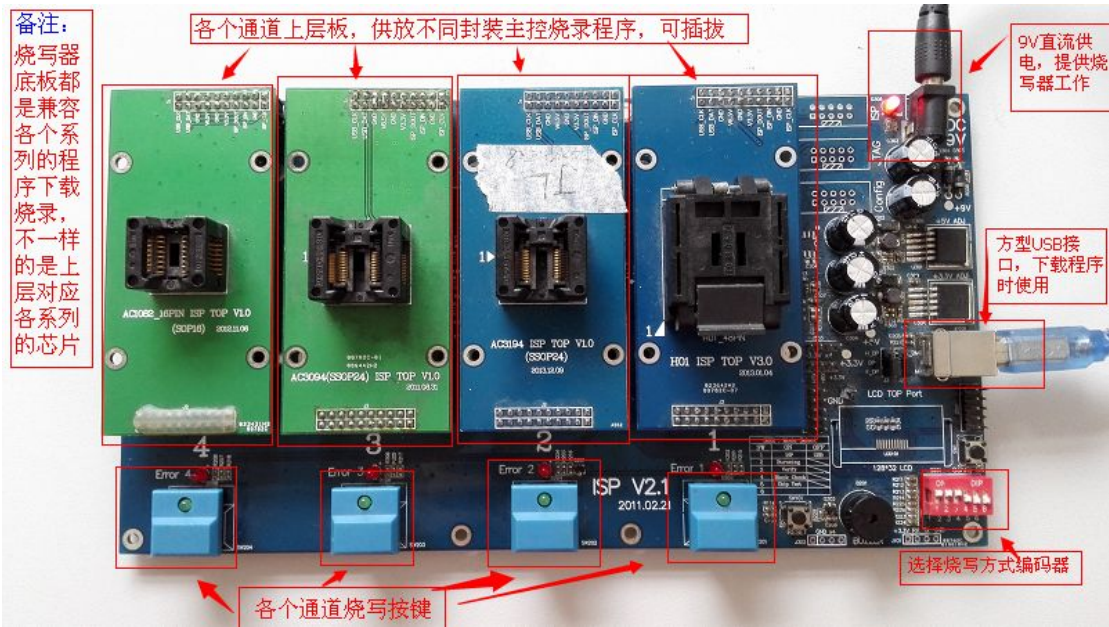


图 7

具体使用说明文档可通过 PC 连接此烧写器，然后右键选择打开选项，，内容如下图 8。

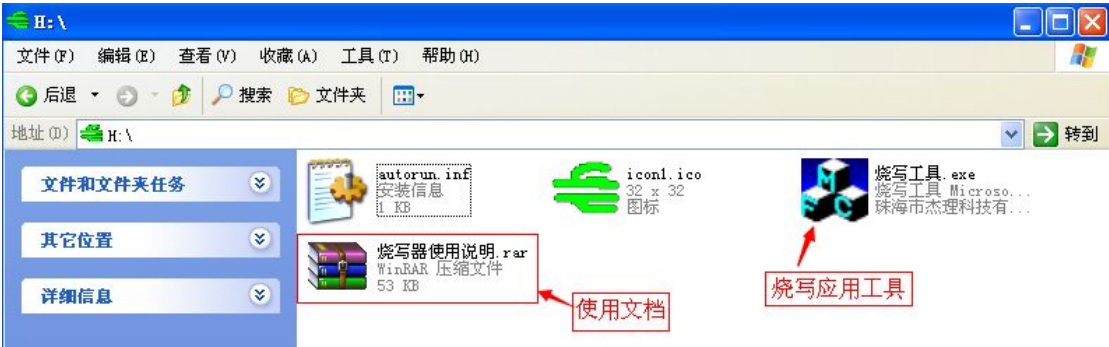


图 8

步骤六：烧写器连接电脑后，打开烧写应用具，如下图 9。

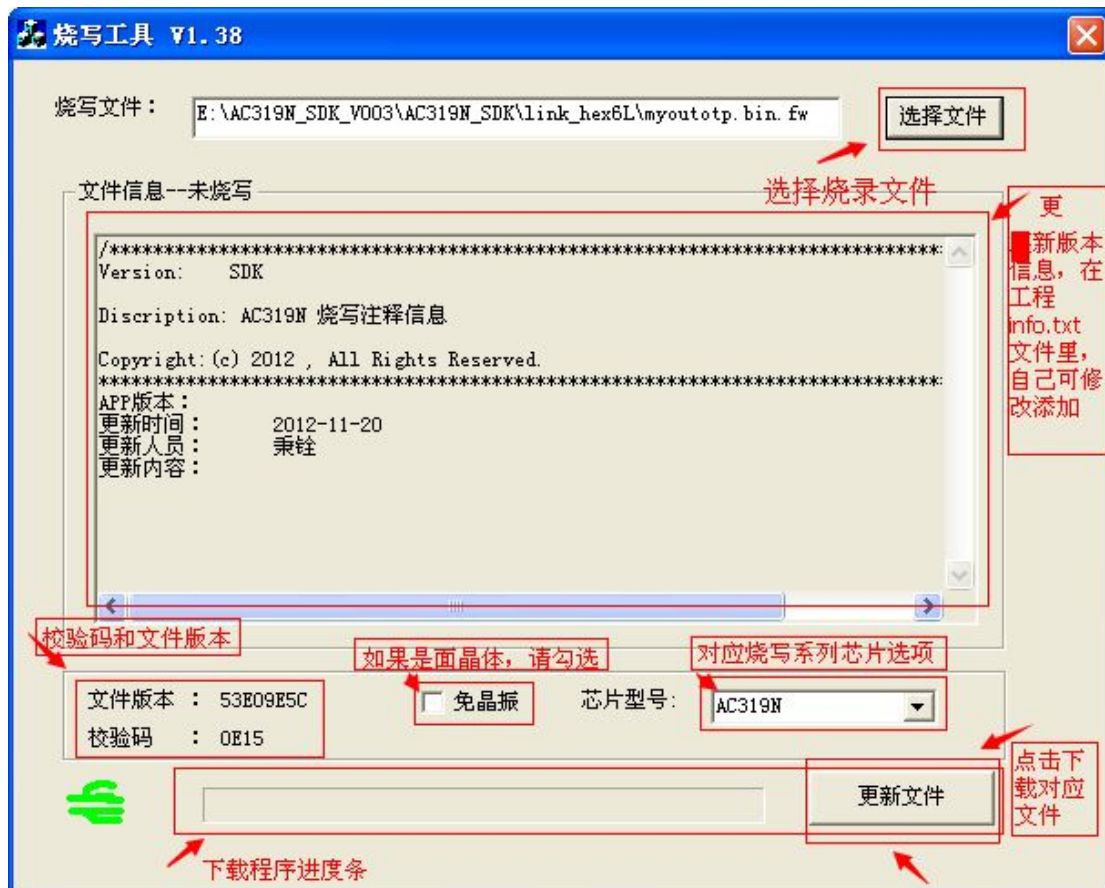


图 9